

Bondexpo 2024

Bondexpo



Die Bondexpo gilt als Leitmesse der Klebetechnik und ist ein wichtiger Branchentreffpunkt für alle Aspekte des industriellen Fügens und Klebens.

Vom **8. bis 11. Oktober** präsentieren sich die Aussteller auf dem Stuttgarter Messegelände, darunter auch Rehm Thermal Systems mit seinem Produktportfolio in den Bereichen Dosieren, Klebetechnologien und Applikationsverfahren.

Mit dem klaren und konsequenten Fokus der Bondexpo auf die Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen werden wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich des Fügens und Verbindens unterschiedlichster Materialien angeboten.

Kommen Sie vorbei - das Team von Rehm Thermal Systems freut sich auf Sie!

Sie finden uns in Halle 5 - Stand 5505!

Beginn:

Dienstag, 8. Oktober 2024, 09:00 Uhr

Ende:

Freitag, 11. Oktober 2024, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Stuttgart

Deutschland

Website & Anmeldung:

<https://www.bondexpo-messe.de/>